

## 半導體設備在地化跨產業聯盟系列活動

# 跨足化合物半導體產業研討會

隨著萬物聯網、5G、電動車等新時代的到來，以砷化鎵 ( GaAs )、氮化鎵 ( GaN )、碳化矽 ( SiC ) 等為代表的化合物半導體，正快速崛起。由化合物所構成的半導體材料，通常由兩種以上的元素構成，依據不同的材料特性，能設計出耐高溫、抗高電壓、高頻、抗輻射與可發光等元件產品，之後再加以開發應用在各種特定領域中。

在當前以矽基為主流的半導體產業，供應鏈已成熟發展，新加入者很難切入設備市場，但台灣化合物半導體生態系統還沒有很完整，正因完整度還不夠，便有機會切入設備供應體系，工具機暨零組件公會特別邀請工研院材化所蕭達慶經理，介紹化合物半導體材料與產業跨足的契機，歡迎有興趣的會員報名參加。

### 【活動議程】

時間	內容	主講人
09:30-10:00	報到	
10:00-10:05	主辦單位開場致詞	
10:05-10:55	化合物半導體材料介紹與產業跨足契機	工研院 材料與化工研究所 精煉純化與先進資源循環技術研究室 <b>Dr. 蕭達慶 經理</b>
10:55-11:10	雙邊及多邊研發補助機制說明	工研院 產科國際所 台歐業務組 <b>Dr. 胥智文 組長</b>
11:10-11:30	問答與討論	

### 線上報名連結

<https://forms.gle/jxuSr3oRBKu3TDd99>

### 【活動資訊】

時間：110年03月16日(週二) 09:30-11:30

地點：PMC 第二辦公室 工廠訓練教室 (台中市南屯區工業 27 路 17 號)

主辦單位：台灣工具機暨零組件工業同業公會(TMBA)

參加對象：工具機製造廠與刀具製造廠、有意跨足半導體產業者

報名方式：免費，線上報名，即日起至 03/12(五)或額滿(50人)為止

洽詢窗口：TMBA 黃瑞庭先生、吳依亭小姐、TEL: 04-23507586

注意事項：本活動完全免費，活動禁止飲食，並全程配戴口罩



【上課地點】



PMC工廠訓練教室



PMC第二辦公室大門



工廠訓練教室位於  
PMC第二辦公室大門  
左前方

